

**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕФЕКТОВ  
В БЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ CdTe,  $Zn_xCd_{1-x}Te$ ,  $CdTe_{1-x}Se_x$   
ОБРАБОТАННЫХ ИОНАМИ АРГОНА**

В. Н. Бабенцов, Г. В. Бекетов, С. И. Горбань

Институт полупроводников Академии наук Украины, 252650, Киев, Украина  
(Получена 9.07.1992. Принята к печати 1.10.1992)

Методами низкотемпературной фотолюминесценции, рентгеновского микроанализа, вторичной ионной масс-спектрометрии в сочетании с послойным стравливанием исследовано изменение примесно-дефектного состава CdTe *p*- и *n*-типов проводимости и твердых растворов  $Zn_xCd_{1-x}Te$  ( $x \leq 0.05$ ) и  $CdTe_{1-x}Se_x$  ( $x \leq 0.05$ ) под действием аргонового травления.

Показано, что в тонком ( $\sim 0.1$  мкм) поверхностном слое в результате обработки возникает новая *S*-полоса фотолюминесценции, которая вызвана рекомбинацией через донорно-акцепторные пары, в состав которых входят атомы Li или Cl, пространственно расположенные в напряженных областях вблизи дислокационных петель или кластеров.

Эффект дальнодействия травления  $Ar^+$  обусловлен термическим нагревом решетки и связанным с ним отклонением от стехиометрии, что вызывает изменение примесно-дефектного ансамбля.

**Введение.** Полупроводниковые соединения CdTe,  $Zn_xCd_{1-x}Te$  и  $CdTe_{1-x}Se_x$  привлекают внимание исследователей ввиду их широкого использования в различных целях, в частности при изготовлении датчиков рентгеновского излучения, солнечных преобразователей и датчиков ИК излучения на основе пленок CdHgTe. Обработка этих материалов проводится обычно с применением механической абразивной полировки, химического или ионного травления, что вносит дополнительные дефекты.

В работе представлены результаты исследования влияния обработки ионами  $Ar^+$  на состав и распределение дефектов в приповерхностной области пластины материала.

Показано, что при малой дозе облучения ( $\sim 10^{12} \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ ,  $t < 30$  мин) основными результатами от воздействия  $Ar^+$  являются медленное травление и изменение ансамбля точечных дефектов. Причинами наблюдаемых эффектов являются создание при обработке ионами  $Ar^+$  локальной нестехиометрии вблизи поверхности, перераспределение остаточных примесей в подрешетках и их гетероравновесие.

Применение для анализа изменения примесно-дефектной системы методов низкотемпературной фотолюминесценции, вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС), рентгеновского микроанализа в сочетании с послойным травлением образца позволило получить новую информацию о распространении воздействия аргоновой обработки в глубь образца.

### Методика эксперимента

В экспериментах использовались образцы монокристаллов CdTe и твердых растворов  $Zn_xCd_{1-x}Te$  и  $CdTe_{1-x}Se_x$  составов, соответствующих  $x \leq 0.05$ , выращенные из расплава. Свежесколотые по плоскости (110) поверхности образцов

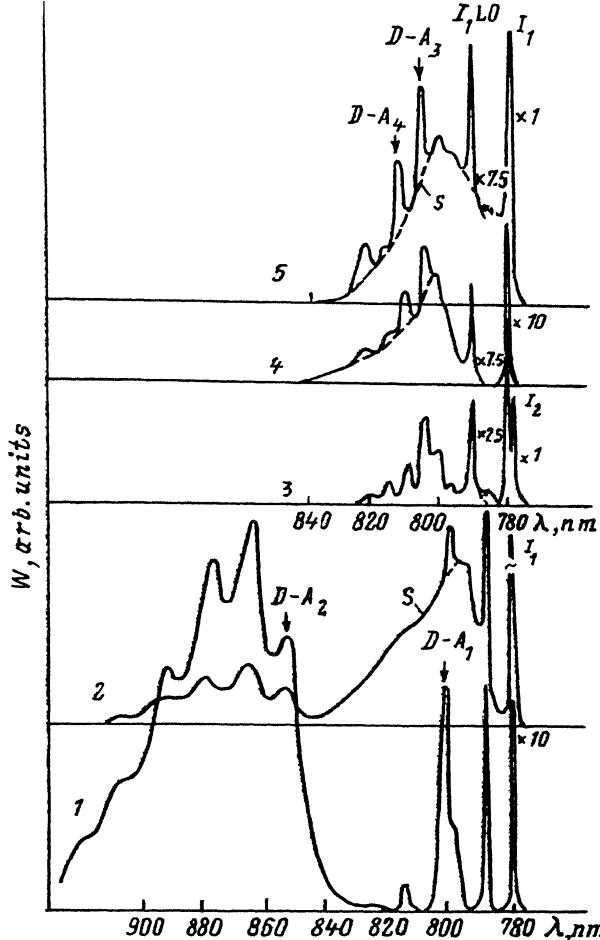


Рис. 1. Спектры низкотемпературной фотолюминесценции  $p$ -CdTe (1, 2),  $n$ -CdTe (3–5). Образцы: 1, 3 – исходные; 2, 4, 5 – обработанные  $\text{Ar}^+$ . 3, 4 соответствуют уровню возбуждения  $I_0$ , 5 – 10  $I_0$ ,  $I_0 = 5$  мВт.  $W$  – интенсивность излучения.

обрабатывались ионами  $\text{Ar}^+$  с энергией 3–5 кэВ и плотностью потока  $10^{12}$   $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$  при 300 К в течение 15–30 мин.

В этих условиях глубина проникновения ионов в материал была около 50–60 Å [1], а доза не достигала порога аморфизации [2].

Спектры фотолюминесценции регистрировали при 4.2 К на установке КСВУ-23. В качестве источника возбуждения использовали Не–Не-лазер с  $\lambda = 632.8$  нм и мощностью 5–10 мВт.

Изменение распределения Cd и Te по толщине образца после обработки  $\text{Ar}^+$  осуществляли рентгеновским микроанализатором JSXA-733, а изменение концентрации примесей в приповерхностной области регистрировали методом ВИМС.

Послойное стравливание образцов проводили в бром-метаноловом травителе.

Измерение толщины стравленного слоя в пределах 0–20 мкм велось с помощью интерференционного микроскопа МИИ-4.

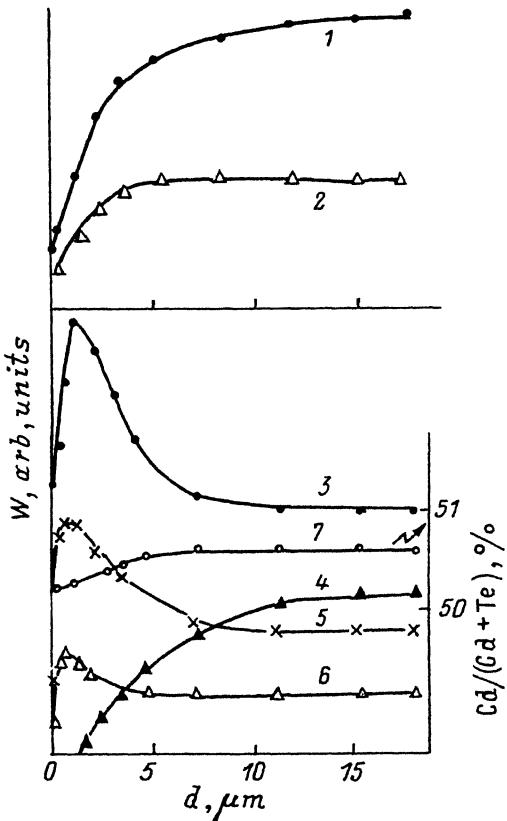


Рис. 2. Профили распределения интенсивностей  $W$  полос фотолюминесценции по глубине стравливания образца  $d$  в  $p\text{-CdTe}$  (1, 2) и  $n\text{-CdTe}$  (3—6), а также отношения сигналов рентгеновского излучения  $\text{Cd}/(\text{Cd} + \text{Te})$  в  $n\text{-CdTe}$  после обработки  $\text{Ar}^+$  или отжига (7). Полосы в спектре  $p\text{-CdTe}$ : 1 —  $I_1$ , 2 —  $D-A_2$ . Полосы в спектре  $n\text{-CdTe}$ : 3 —  $I_1$ , 4 —  $I_2$ , 5 —  $D-A_3$ , 6 —  $D-A_4$ .

### Экспериментальные результаты

1. **Теллурид кадмия.** В спектре низкотемпературной фотолюминесценции исходных образцов  $p\text{-CdTe}$  (рис. 1, кривая 1) присутствуют: линия излучения экситона, связанного на акцепторе  $I_1$  (779.8 нм), и полосы донорно-акцепторного излучения с максимумами при 801.7 нм ( $D-A_1$ ) и 850 нм ( $D-A_2$ ).

Спектры люминесценции исходных образцов  $n\text{-CdTe}$  (рис. 1, кривая 3) существенно отличаются от аналогичных спектров  $p\text{-CdTe}$ . В них, кроме линии  $I_1$  (779.9 нм), имеется линия экситона, связанного на доноре  $I_2$  (778.2 нм), и полосы донорно-акцепторного излучения 804 нм ( $D-A_3$ ) и 810 нм ( $D-A_4$ ).

Согласно работам [3, 4], акцепторы  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  включают в себя остаточные примеси Cl, Cu, Li, P.

После обработки аргоном в спектрах фотолюминесценции обоих образцов появляется новая  $S$ -полоса в области 790—820 нм (рис. 1, кривые 2, 4—5). Положение максимума этой полосы смещается в сторону меньших длин волн при повышении уровня возбуждения.

Стравливание нарушенного поверхностного слоя на глубину 0.1 мкм приводит к удалению  $S$ -полосы из спектра фотолюминесценции. Такой же результат дает и отжиг обработанного ионами  $\text{Ar}^+$  образца в течение 1 ч при  $T > 400^\circ\text{C}$ .

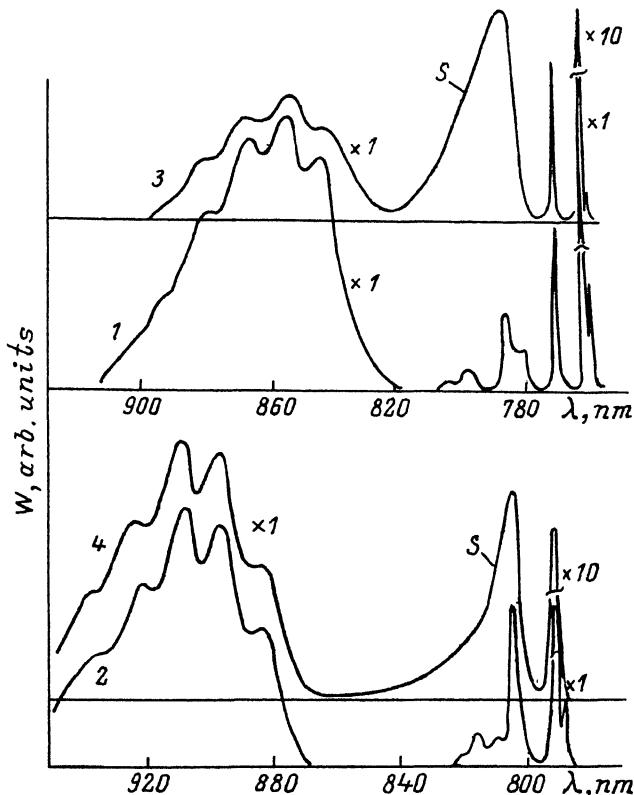


Рис. 3. Спектры низкотемпературной фотолюминесценции кристаллов  $Zn_xCd_{1-x}Te$  с  $x = 0.035$  (1, 3) и  $CdTe_{1-x}Se_x$  с  $x = 0.04$  (2, 4). Образцы: 1, 2 — исходные; 3, 4 — после обработки  $Ar^+$ .  $W$  — интенсивность излучения.

Общий выход излучения низкотемпературной фотолюминесценции после обработки  $Ar^+$  падает на всех образцах.

В образцах  $n$ -типа проводимости в разупорядоченном слое полностью исчезает полоса  $I_2$ , а интенсивность  $I_1$  уменьшается в 2—3 раза.

В образцах  $p$ -типа проводимости после обработки  $Ar^+$  наблюдается падение интенсивности полосы  $I_1$  в 5—10 раз.

Интенсивность всех донорно-акцепторных полос после обработки  $Ar^+$  уменьшается в образцах обоих типов в 2—3 раза.

При послойном стравливании нарушенного материала наблюдается восстановление исходных спектров фотолюминесценции, но профили распределения интенсивностей линий излучения в глубь объема образцов от поверхности различны для  $n$ - и  $p$ -CdTe.

Стравливание образца  $p$ -типа дает монотонное увеличение интенсивности линии  $I_1$  и полос  $D-A_{1,2}$  до значений, равных интенсивностям исходного образца (рис. 2).

В образце  $n$ -типа по мере стравливания  $I_1$  возрастает до максимального значения, в 3—5 раз превышающего интенсивность  $I_1$  в исходном образце, а затем спадает до величины в исходном образце. С началом спада  $I_1$  в спектре люминесценции появляется линия  $I_2$ , интенсивность которой также стремится к исходному значению (рис. 2, б, кривая 2). Существенно, что профиль  $I_2$  повторяет профиль распределения характеристического рентгеновского излучения кадмия (рис. 2, кривая 5).

После обработки  $\text{Ar}^+$  в приповерхностной области зарегистрировано методом ВИМС повышение сигнала Li в 8 раз, фосфора и кислорода в 1.5–2 раза.

Аналогичные представленным на рис. 2 профили интенсивностей полос низкотемпературной фотолюминесценции были получены также после нагрева образцов *n*-типа проводимости в запаянной ампуле при  $T = 350\text{--}400^\circ\text{C}$ .

2. *Твердые растворы*  $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$  и  $\text{CdTe}_{1-x}\text{Se}_x$ . Исходный спектр низкотемпературной фотолюминесценции образцов  $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$  ( $x = 0.035$ ) представлен на рис. 3 кривой 1. В нем, как и в спектре *p*-CdTe, доминирует линия  $I_1$ . Ее полуширина определяется флуктуацией состава и в 3–4 раза превышает полуширину линии  $I_1$  в CdTe. В спектре также присутствует *D*–*A*-полоса на 840 нм с *LO*-фононными повторениями.

После воздействия на образец ионами  $\text{Ar}^+$  его спектр фотолюминесценции изменяется качественно так же, как и спектр *p*-CdTe. Интенсивность  $I_1$  падает в 3–4 раза без изменения полуширины (рис. 3, кривая 3). Интенсивность полосы 840 нм также уменьшается в 3–4 раза. В области 780–820 нм появляется *S*-полоса.

Исходный спектр фотолюминесценции  $\text{CdTe}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x = 0.04$ ) представлен на рис. 3 кривой 2. Он подобен спектру *n*-CdTe, поскольку интенсивность линии  $I_2$  (789.6 нм) в нем сравнима с интенсивностью линии  $I_1$  (794.0 нм). Вследствие флуктуаций состава уширена преимущественно линия  $I_1$  (полуширина  $\Delta H = 5.7$  мэВ). Полуширина линии  $I_2$  составляет 1.2–1.5 мэВ и не зависит от обработки, в то время как полуширина  $I_1$  увеличивается после воздействия  $\text{Ar}^+$  до значения  $\Delta H = 6.8$  мэВ.

Обработка  $\text{Ar}^+$  приводит к резкому падению интенсивности  $I_2$  и появлению *S*-полосы в области 800–840 нм (рис. 3, кривая 4).

## Обсуждение результатов

Как видно из эксперимента, аргоновое травление вызывает изменение примесно-дефектного состава материалов как непосредственно в области проникновения ионов, так и на значительном удалении от нее.

Из литературы известно [5], что в результате аргонового травления поверхность теллурида кадмия остается в стехиометрическом состоянии, т. е. на ней отсутствует слой избыточного теллура или кадмия. Вместе с тем травление  $\text{Ar}^+$  приводит к появлению на свежескошлойтой поверхности ямок вследствие неодинаковой скорости удаления теллурида кадмия и включений теллура или кадмия. Кроме того, ионная обработка приводит к образованию дислокационных петель [6, 7].

Таким образом, в разупорядоченном аргоновым травлением слое существенно изменяются условия рекомбинации на исходных дефектах материала, а также в нем возможно появление новых дефектов и обусловленных ими полос фотолюминесценции.

После обработки аргоном CdTe и твердых растворов на его основе, полосы фотолюминесценции, связанные с дефектами, обычно присущими объему этих материалов, наблюдались в работе [1].

В наших экспериментах после обработки  $\text{Ar}^+$  появлялась новая полоса поверхностного происхождения.

Поскольку во всех образцах — CdTe,  $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$  и  $\text{CdTe}_{1-x}\text{Se}_x$  — *S*-полоса расположена в области *D*–*A*-полос, за которые в качестве акцепторов отвечают Li или Cl, то можно полагать, что ее обуславливает рекомбинация на таких же дефектах, но расположенных вблизи поверхности. В этой области имеются микронарушения (дислокационные петли, кластеры), вблизи которых присутствуют механические напряжения, вызывающие локальные изменения ширины запрещенной зоны.

Рекомбинация электронов и дырок может при этом происходить как с уровняй акцепторов, оказавшихся пространственно вблизи микронарушения, так и с собст-

венных уровнях потенциальной ямы. Такая модель рассмотрена для Si с учетом реальных изменений параметра решетки вблизи включений в работе [8].

После стравливания разупорядоченного слоя интенсивность полос фотолюминесценции в образцах *p*-типа проводимости все же значительно слабее, чем в исходном состоянии, вплоть до удаления материала на глубину до 20—25 мкм (рис. 2, *a*). Это свидетельствует о том, что эффект дальнодействия от аргоновой обработки сравним с эффектом от механической шлифовки образца абразивом с диаметром зерна 5—10 мкм [9].

Причиной такого дальнодействия травления Ar<sup>+</sup> является, очевидно, не уменьшение концентрации акцепторных центров, обусловливающих фотолюминесценцию, а образование центров безызлучательной рекомбинации, как и в случае механического воздействия на материал.

В образцах *n*-CdTe после обработки Ar<sup>+</sup> при послойном стравливании интенсивности *D*—*A*-полос и линии *I*<sub>1</sub> сначала возрастают, но затем достигают максимальных значений и спадают до величин, характерных для исходного кристалла. Интенсивность линии *I*<sub>2</sub> при этом возрастает до исходного значения в объеме образца (рис. 2, *b*). Превышение в 3—5 раз интенсивности *I*<sub>1</sub> в приповерхностном слое над ее значением в объеме образца при одновременном падении интенсивности *I*<sub>2</sub> свидетельствует о том, что в результате обработки Ar<sup>+</sup> часть атомов Li переходит из донорного состояния Li<sub>d</sub> в акцепторное состояние Li<sub>Cd</sub>. При этом общая концентрация Li вблизи поверхности по данным ВИМС возрастает в 8 раз при уменьшении концентрации кадмия (рис. 2, *b*). Этот процесс может приводить к изменению типа проводимости в приповерхностном слое.

Падение квантового выхода излучения по мере приближения к нарушенной обработкой Ar<sup>+</sup> поверхности, так же как и в образцах *p*-CdTe, можно объяснить лишь появлением безызлучательного канала рекомбинации.

Прямыми доказательством термического влияния обработки Ar<sup>+</sup> на перераспределение примесей и собственных дефектов в решетке является тот факт, что аналогичные профили распределения сигнала фотолюминесценции получаются и после кратковременного отжига образцов в вакуумированной ампуле (рис. 2, *b*). Вместе с тем при термическом отжиге поверхности образцов квантовый выход фотолюминесценции понижен так же, как и после обработки Ar<sup>+</sup>. Этот факт свидетельствует о том, что причиной понижения квантового выхода не являются протяженные дефекты решетки типа дислокационных петель, созданные в результате обработки Ar<sup>+</sup>. По-видимому, в приповерхностной области образования центров безызлучательной рекомбинации происходит за счет ассоциирования точечных дефектов в кластерах.

**Выводы.** В результате обработки Ar<sup>+</sup> образцов теллурида кадмия *n*- и *p*-типов проводимости, а также твердых растворов Zn<sub>x</sub>Cd<sub>1-x</sub>Te (*x* = 0.035) и CdTe<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (*x* = 0.04), в их спектрах фотолюминесценции появляется новая *S*-полоса излучения. Ответственные за ее появление дефекты расположены в приповерхностном слое толщиной менее 0.1 мкм. По-видимому, они представляют собой «объемные» *D*—*A*-пары, в состав которых входит Li и Cl, расположенные в напряженных микрообластях вблизи дислокационных петель или кластеров.

Эффект от воздействия ионами Ar<sup>+</sup> при травлении поверхности распространяется в глубину кристалла на расстояние, много большее, чем глубина проникновения ионов, и обусловлен нагревом решетки и связанным с ним отклонением от стехиометрии. Это вызывает появление центров безызлучательной рекомбинации, изменяет положение примесей в решетке кристалла, приводит к геттерированию примесей.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] H. Neff, K. Y. Lay, M S. Su, P. Lange, K. J. Bachmann. Surf. Sci., **189/190**, 661 (1987).
- [2] T. W. Sigmon. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, **7/8**, 402 (1985).
- [3] E. Molva, J. P. Chamonal, J. L. Pautrat. Phys. St. Sol. (b), **109**, 635 (1982).
- [4] H. В. Агринская, В. В. Шашкова. ФТП, **22**, 1248 (1988).
- [5] A. J. Ricco, H. S. White, M. S. Wrighton. J. Vac. Sci. Techn. A, **2**, 910 (1984).
- [6] A. M. Gue, A. Mazel. J. Cryst. Growth., **72**, 910 (1985).
- [7] U. Solgbach, H. J. Richter. Surf. Sci., **97**, 191 (1980).
- [8] H. Weman, V. Monemar, G. S. Ochrlein, J. S. Leng. Phys. Rev. B, **42**, 3109 (1990).
- [9] В. Н. Бабенцов, С. И. Горбань, В. П. Кладько, А. В. Фомин. ОМП, вып. 7, 34 (1989).

Редактор Л. В. Шаронова

---